



發佈日期：

2011年7月13日

發佈單位：

達能科技股份有限公司

達能科技於2011年7月13日舉辦晶圓三廠上樑典禮

達能科技股份有限公司 (股票代號：3686)於2011年7月13日在桃園縣觀音鄉桃園科技工業園區舉行晶圓三廠上樑典禮。達能科技晶圓三廠規劃建置約220MW廠房與產能設備，預計今年第四季完工並準備投產，屆時觀音廠總裝置產能將上看550MW。

由於第二季受到歐洲市場補助政策不確定的影響，終端市場投資觀望，導致需求凍結、庫存水位過高，多數太陽能廠產能利用率普遍下滑。但近期受到市場逐步回溫影響，電池廠擴產已醞釀復工，達能擴產腳步亦持續進行。達能科技方震銘總經理表示：「太陽光電仍是未來替代能源的主要發展方向，我們的擴產腳步不會停歇，只會依據市況更機動地調整產能到位的時程，我們將保持最佳彈性，等待市場需求與景氣的復甦。」

關於達能科技：

達能科技為國內第一家以科技類股上市的太陽能矽晶圓廠，擁有完整的矽晶圓生產線，以頂尖研發實力傲視業界，其多晶矽晶圓優異的品質及轉換效能表現，已普遍獲得國內外太陽能電池大廠肯定；除了多晶矽晶圓核心技術的品質見證，達能更加強矽晶材料技術的研發，以最先進的生產技術及高效率管理，提升品質與成本管控保有競爭的優勢地位。

聯絡人：

吳育宜

財務長

pr@danentech.com

+886 3 4738788